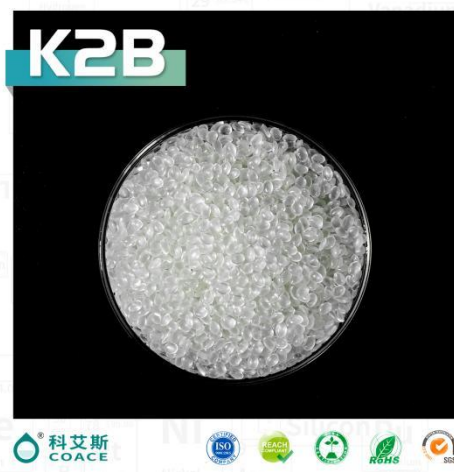


探索材料新境界 共赴材料创新之旅

在本次包装制品展上，我们展示了核心三款材料技术，本次产品的展示不仅是对我们研发成果的展示，更希望与行业内的专家和企业共同探讨，一起描绘包装行业的未来蓝图。通过对这些新材料的了解和讨论，我们期待激发新的合作机会，共同推动包装领域的创新和进步。

粘接树脂-K2B

该产品为马来酸酐官能化的乙烯-醋酸乙烯酯共聚物，极性改性树脂，具有非常优异的粘接性，优异的相容性。在包装应用领域，可以与本身或其它树脂的低温热封，也可用于复合瓶盖衬垫，还可以制成吹塑、挤出、流延及共挤薄膜，与其它树脂混合使用。



粘接树脂-W1L-A

该产品为马来酸酐官能化的聚乙烯，在非极性的聚烯烃分子链上化学接枝极性的马来酸酐基团，可实现聚烯烃树脂和 PA/EVOH 树脂的粘接。可应用于气柱膜、气球膜、食品和化学品包装膜等。具有粘接强度高，晶点黑黄点少，优异的加工性能等优势。



可降解相容剂 BP-2

此产品是一种包含缩水甘油酯官能团的接枝聚合物，可降解聚酯弹性体作为基体材料，反应活性高，残留低，其自身可全降解，具有白色或微黄的颗粒外观。主要应用在 PLA、PBAT 等材料与淀粉、竹粉、无机矿粉的填充改性、PLA 增韧改性、PLA/PBAT 合金相容剂选项，共同推动行业的可持续发展。



我们诚挚地邀请展会上的各位同仁一起探讨新材料的应用潜力和行业影响，利用创新技术来应对当前和未来的包装挑战，携手开启包装行业的新篇章。